



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H150-LD 专用系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 高导热
- 低密度
- 高绝缘
- 防火性能高

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法	
颜色	灰色	---	目视	
厚度	1~3	mm	ASTM D 374	
硬度	35±5	Shore C	ASTM D 2240	
密度	1.8±0.15	g/cc	ASTM D 792	
拉伸强度	≥ 0.2	Mpa	ASTM D 412	
延伸率	≥ 200	%	ASTM D 412	
压缩保持力	20%	15	Psi	ASTM D 695
	30%	30.69	Psi	ASTM D 695
撕裂强度	≥ 1.5	N/mm	ASTM D 624	
阻燃等级	V0	---	UL-94	
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14	

热学特性

导热系数	1.2±0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 2.0 (@20Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 10	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

